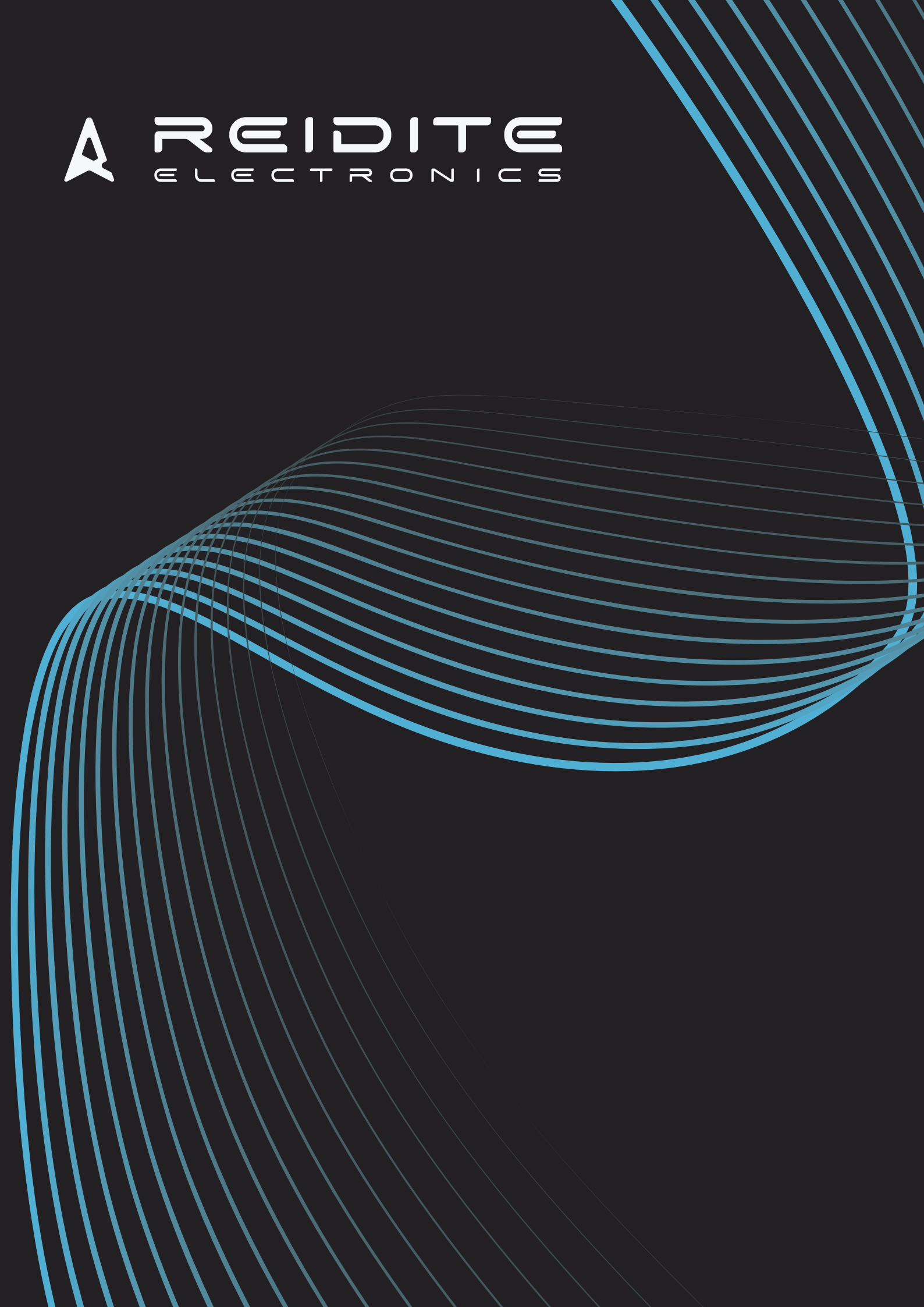




**REIDITE**  
ELECTRONICS

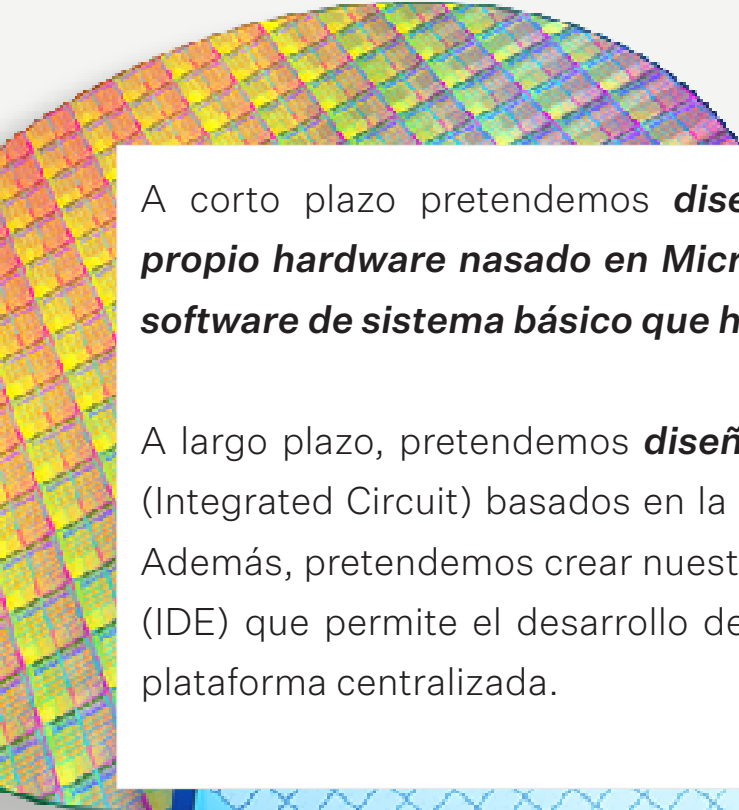


# ÍNDICE

- 01. Resumen de la empresa**
- 02. Posición competitiva y Mercado**
- 03. Sector, competencia y clientes**
- 04. Equipo humano y organigrama**
- 05. Crecimiento económico y escalabilidad del negocio**
- 06. Producto**
- 07. Objetivos**
- 08. Grado de innovación y reto tecnológico**


# RESUMEN DE EMPRESA

REIDITE Electronics es una empresa de ingeniería fundada a principios de 2024 en Madrid, España. Nace con la visión de liderar el espacio europeo de microelectrónica y electrónica a corto plazo, y a largo plazo dar el salto hacia la arquitectura RISC-V

A circular microchip die with a colorful, multi-layered grid pattern in shades of yellow, orange, and purple.

A corto plazo pretendemos **diseñar, desarrollar y fabricar nuestro propio hardware basado en Microcontroladores y FPGAs e Incluir un software de sistema básico que hace nuestro hardware plug and play.**

A largo plazo, pretendemos **diseñar e integrar nuestros propios chips** (Integrated Circuit) basados en la arquitectura de computadores RISC-V. Además, pretendemos crear nuestro propio entorno de desarrollo integrado (IDE) que permite el desarrollo de software de nuestros clientes en una plataforma centralizada.

A circular microchip die with a blue grid pattern and several small black square features.

# TECNOLOGÍA

En REIDITE Electronics SL diseñamos y fabricamos **módulos electrónicos estandarizados** que se utilizan para el control de sistemas físicos, **sistemas de alto rendimiento orientados a sistemas críticos y no críticos**. Pretendemos ofrecer productos robustos, siguiendo los más altos estándares existentes en las industrias tecnológicas, así como cumplir con los requisitos más exigentes y estrictos a través de certificar, validar y homologar nuestros productos.

Estos **módulos electrónicos estandarizados** se denominan **System On Modules** (SoM) son tarjetas electrónicas de pequeño tamaño, en concreto **Compute Module**, de 55x40 mm o formato **M.2**, de 22x60mm y un grosor de apenas 4mm. Estos módulos son objeto de un innovador proceso de encapsulamiento, desarrollado y pendiente de patente por nuestra parte, que mejora sus características físicas. Este procedimiento no solo aumenta la resistencia del dispositivo, sino que también potencia sus capacidades operativas



# EQUIPO

Chief Executive Officer (CEO)  
Co-Founder  
Carlos Vaello Martínez



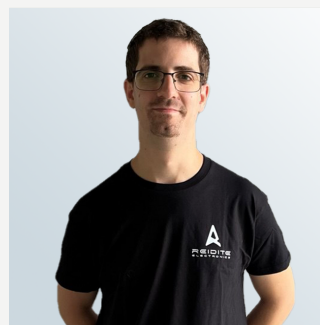
Chief Technology Officer (CTO)  
Co-Founder  
Manuel Luis Alcazar Laynez

Manager Director (MD)  
Main Manager  
Julieta Gerbaudo Delfino

Hardware Manager  
Hardware  
Estefanía Llano Perez

Software Manager  
Software  
Carlos Cotano Barroso

Fabricación Manager  
Fabricación  
Jorge de la Fuente Muelas



Chief Technology Officer (CTO)  
Co-Founder  
Manuel Luis Alcazar Laynez

Chief Executive Officer (CEO)  
Co-Founder  
Cesar David Vera Moreno

# PRODUCTOS

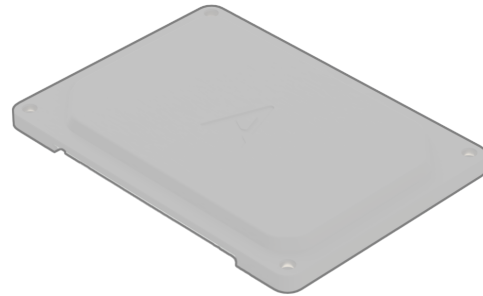
**XIPHOS**  
MPU + uFPGA

2025



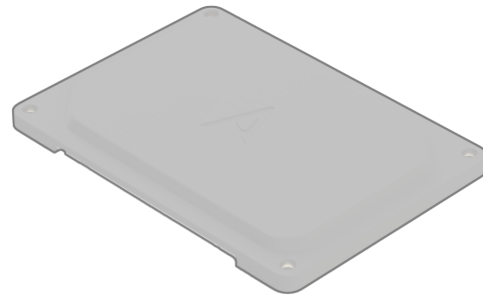
**ZENITH**  
FPGA + ARM Cores

2026



**NEXAR**  
FPGA + RISC-V Softcores

2027 



**ATLAS**  
FPGA + RISC-V Cores

2028 

